



## Tagesordnung

Thema: 64. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **Mittwoch, 10. Oktober 2018, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
**Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung**  
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr  
**Verwindungen und Verwölbungen im Lötprozess - Messung, Auswirkungen und Gegenmaßnahmen**  
Herr Dr. Meier, TU Dresden, Dresden
- 3 11:10 Uhr  
**Verbesserung großflächiger Lotverbindungen mittels gerichteter Erstarrung**  
Herr Hutzler, Pink GmbH Thermosysteme, Wertheim
- 4 11:50 Uhr  
**3D wire - a novel approach for 3D chips interconnection for harsh environment applications**  
Herr Bickel, HTW Berlin, Berlin
- 5 12:30 Uhr  
Mittagessen

- 6 13:30 Uhr  
**Reinigung elektronischer Baugruppen - Bewertung des Reinigungserfolges und mögliche Schädigungspotentiale**  
Herr Knofe, Siemens AG, Berlin
- 7 14:10 Uhr  
**Embedding Technologien für heterogene Integration von Bauteilen in PCB**  
Herr Pawlikowski, TU Berlin, Berlin
- 8 14:50 Uhr  
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr  
**Zuverlässigkeit – Lebensdauerabschätzung für industrielle Messtechnik**  
Herr Scheibner-Aden, imc Test & Measurement GmbH, Berlin
- 10 15:40 Uhr  
**Mechanische Zuverlässigkeit von dehnbaren Schaltungsträgern**  
Herr Dr. Walter, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr  
**Abschlussdiskussion**  
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**